

104學年度 電子工程系 碩士班全學程開課時序表

第一學年(104)					
科 目		第一學期		第二學期	
		學分	時數	學分	時數
必修	※專題討論(一)(二)	1	2	1	2
	科技英文寫作	1	2		
	科技英文語練			1	2
小 計		2	4	2	4

第二學年(105)					
科 目		第一學期		第二學期	
		學分	時數	學分	時數
必修	※論文(一)(二)	3	3	3	3
小 計		3	3	3	3

第一學期			
科 目		學分	時數
選修	高等電磁理論	3	3
	高等通訊理論	3	3
	高等射頻電路設計	3	3
	微波工程	3	3
	微帶天線設計	3	3
	高階積體電路量測技術	3	3
	高階積體電路合成設計	3	3
	高階數位積體電路設計	3	3
	半導體製程整合技術	3	3
	固態電子學	3	3
	半導體物理	3	3
	量子電子學	3	3
	濾波器設計與分析	3	3
	高等數位訊號處理	3	3
	高等工程數學	3	3
	系統晶片導論	3	3
	Zigbee無線感測網路系統	3	3
	數位電視機上盒開發	3	3
	光電工程(一)	3	3
	高等電磁理論	3	3
必修	半導體製程技術	3	3
	半導體元件物理	3	3
	光纖元件	3	3
	光電子學	3	3
	平面顯示器技術	3	3
	智慧型照明系統設計	3	3
	高階積體電路測試技術	3	3
小 計		81	81

第二學期			
科 目		學分	時數
選修	系統晶片設計實務	3	3
	個人無線通訊系統	3	3
	微波電路設計	3	3
	行動天線設計與量測	3	3
	光纖通訊工程	3	3
	平面顯示器原理	3	3
	網路電視(IPTV)	3	3
	射頻積體電路設計	3	3
	元件量測與可靠度分析	3	3
	高階積體電路實體設計	3	3
	高階類比積體電路設計	3	3
	高階硬體語言與IC設計	3	3
	記憶元件與電路設計	3	3
	高階數位影像處理	3	3
	高階半導體封裝技術	3	3
	光電工程(二)	3	3
	薄膜量測技術	3	3
	光電元件量測技術	3	3
	光電元件物理	3	3
	太陽能光伏發電技術	3	3
必修	數位通訊理論	3	3
	行動通訊產業分析	3	3
	奈米積體電路技術	3	3
小 計		69	69

項目	學分	時數
※專業必修	8	10
一般必修	2	4
專業選修	24	24
合計	34	38

備註:

- 1.一年級每學期應修習6-15學分，二年級每學期應修習3-15學分
- 2.最低畢業學分：34學分;含必修及論文學分10學分;選修學分24學分。
- 3.本所允許跨所選修，惟本所專業選修學分不得低於21學分。
- 4.論文必修6學分，分兩學期排課，待口試通過後一次給予評分。
- 5.本所選修課程不分學年，僅分第一、二學期，由指導老師輔導選課。
- 6.表列選修課程僅供參考，依實際狀況調整。